

# 关于举办“2026 第三届半导体行业用金刚石材料技术大会暨 功率半导体技术应用与装备研讨会”的通知

金刚石材料，集超高硬度、超宽禁带、极限热导率、超高载流子迁移率等卓越特性于一身，不仅在半导体制造环节（如切割、研磨、抛光与先进封装）扮演着日益重要的角色，更在功率半导体、射频器件等前沿领域展现出颠覆性应用的广阔前景，被誉为“终极半导体材料”。推动金刚石材料从实验室走向规模化应用，已成为抢占下一代半导体技术制高点的关键。

与此同时，以碳化硅、氮化镓为代表的功率半导体技术已进入规模化应用阶段，深刻变革着新能源汽车、绿色能源、工业控制等领域的产业格局。其应用生态的成熟高度依赖于材料生长、器件制造、封装测试及专用装备等全链条的协同创新。

为深化产业交流，促进“材料-器件-装备-应用”的生态融合，在前两届大会成功积淀的基础上，中粉会展将于 2026 年 9 月 3 日在河南·郑州举办“2026 第三届半导体行业用金刚石材料技术大会暨功率半导体技术应用与装备研讨会”。大会将深入探讨金刚石材料在半导体制造与器件应用中的最新技术突破、产业化瓶颈与解决方案，并同步关注功率半导体技术的应用趋势、可靠性挑战及核心装备的自主创新。

大会热忱欢迎金刚石材料研发制造、器件设计、装备开发、终端应用及相关投资领域的专家学者、技术精英与企业代表莅临参会，并诚挚邀请相关单位展示最新技术、产品与解决方案，共谋产业发展，共赢未来市场。

## 时间:

2026年9月3日

## 地点:

无锡

## 主办单位:

中国粉体网

中粉会展

## 会议议题:

- 1、高性能金刚石粉体的制备与改性技术研究
- 2、金刚石半导体技术发展现状与应用前瞻
- 3、金刚石半导体产业化发展难点分析与成本控制路径探讨
- 4、大尺寸单晶金刚石生长技术进展
- 5、单晶金刚石衬底切磨抛加工技术进展
- 6、金刚石线切割技术在半导体制程中的创新与应用
- 7、金刚石研磨垫/抛光液在半导体制程中的应用突破
- 8、金刚石半导体器件的设计与制造
- 9、金刚石量子器件（色心）在半导体技术的应用前景分析
- 10、金刚石薄膜的制备技术进展
- 11、金刚石掺杂技术进展
- 12、金刚石热界面材料导热性能优化与可靠性研究
- 13、金刚石/金属复合材料技术现状及应用前瞻
- 14、碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体技术及应用现状

15、氮化铝、氧化镓等超宽禁带半导体技术开发现状

16、功率半导体制造关键装备（如烧结，单晶生长炉、外延炉、高温离子注入机、激光退火、键合机）的国产化进展与技术攻关

17、功率半导体制造装备关键零部件技术现状

### 会议费用：

2800 元/人

包含会刊资料、茶歇、午餐、晚宴，不包含住宿费用

### 收款账户：

单位名称:山东中粉会展服务有限公司

开户银行:中国银行股份有限公司临沂北城支行

账户:233841636876

### 大会赞助：

(赞助详细内容请联系会务组了解)

1、协办赞助(含展位、企业致辞，会议期间 360 度环屏广告，视频播放，企业报告等)

2、晚宴赞助(含展位、晚宴 360 环屏大屏展示、晚宴致辞、主持人口播广告等)

3、其它赞助(会议礼品、环屏广告、侧屏广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等)

4、展位展示(展示桌椅+展位背景墙广告)

## 会务组:

联系人: 刘文宝

电 话: 13693335961 (同微信)

